

中信证券股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司

确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的核 查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海合晶”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事毛瑞源、焦平海及邵中和对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了上述议案，独立董事认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。

4、本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

(二) 公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计发生金额	2025 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和服务及其他	合晶科技股份有限公司及其下属公司	15,000.00	8,567.56	受合晶科技客户终端产品需求减缓影响
接受关联人提供的产品和服务及其他	合晶科技股份有限公司及其下属公司	18,000.00	8,890.32	受实际需求减少影响
	盛美半导体设备(上海)股份有限公司及其下属公司	4,000.00	2,319.66	受实际需求减少影响
	小计	22,000.00	11,209.98	

(三) 公司 2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 2026 年度金额	占同类业务比例	2025 年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计 2026 年度金额与 2025 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、	合晶科技股份有限	12,000.00	9.15%	8,567.56	6.53%	预计销售量增加

商品和服务及其他	公司及其下属公司					
接受关联人提供的产品和服务及其他	合晶科技股份有限公司及其下属公司	20,000.00	21.52%	8,890.32	9.56%	根据实际经营需要, 预期采购需求增加
	盛美半导体设备(上海)股份有限公司及其下属公司	3,000.00	3.23%	2,319.66	2.50%	根据实际经营需要, 预期采购需求增加
	小计	23,000.00	24.75%	11,209.98	12.06%	-

注: 公司董事焦平海之兄弟 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 于 2025 年 3 月 11 日离任盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事职务, 故 2026 年 3 月 11 日起盛美半导体设备(上海)股份有限公司将不再被认定为公司的关联方, 上表中其本次预计 2026 年度金额为预计截至 2026 年 3 月 11 日发生的日常关联交易金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 合晶科技股份有限公司

企业名称	合晶科技股份有限公司			
统一编号	16138282			
企业性质	股份有限公司(中国台湾上柜)			
成立时间	1997 年 7 月 24 日			
负责人	焦平海			
实收资本	新台币 5,737,967,300 元(更新日期 2025 年 12 月 23 日)			
住所及主要办公地点	中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路 100 号			
主营业务	半导体硅片及其材料的研发、设计、制造、进出口及代理销售等			
2024 年度主要财务数据 (单位: 新台币千元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	34,504,925	25,693,181	8,721,123	293,845
关联关系	合晶科技股份有限公司为公司间接控股股东			
履约能力	合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常, 财务状况较好, 为专业的半导体硅材料研发设计制造加工公司, 具备良好履约能力和支付能力, 前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行, 双方履约具有法律保障。			

(二) 盛美半导体设备(上海)股份有限公司

企业名称	盛美半导体设备（上海）股份有限公司			
统一社会信用代码	91310000774331663A			
企业性质	股份有限公司（外商投资、上市）			
成立时间	2005年5月17日			
法定代表人	HUI WANG			
注册资本	480,164,789元			
住所及主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄5、6、7、8号全幢			
主营业务	半导体专用设备的研发、生产和销售			
2025年度主要财务数据 （单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	1,889,489.47	1,347,084.55	678,617.02	139,544.21
关联关系	公司董事焦平海之兄弟STEPHEN SUN-HAI CHIAO在过去12个月内曾担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事，公司将盛美半导体设备（上海）股份有限公司认定为公司关联方。			
履约能力	盛美半导体设备（上海）股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业的半导体专用设备的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。			

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会和股东会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全

部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次确认 2025 年度日常关联交易以及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，未损害公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。保荐人对公司本次确认 2025 年度日常关联交易以及 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

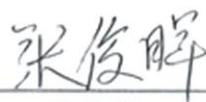
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：



谢雯



张俊晖

